附件4

**2024年“中国芯”优秀产品征集活动**

**“芯火”新锐产品申报表**

**国家“芯火”双创基地推荐单位标准**

面向市场前景好、发展潜力大、科技创新特征鲜明的集成电路创新创业项目，鼓励国家“芯火”双创基地依照如下标准向中国芯秘书处推荐优秀项目（推荐项目仅需满足如下标准之一）。

**标准一：**

1、近两年营业收入连续增长，且复合增长率不低于30%；

2、最近两年的研发投入合计占最近两年营业收入合计的比例在15%以上，或最近两年研发投入金额累计在800万元以上；

3、形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）3项以上（含受理中的发明专利）。

**标准二：**

1、核心技术具有鲜明的路径创新优势，可以说明新技术对现有技术的迭代创新或应用替代的优势。

**标准三：**

1、依靠核心技术形成的主要产品面向国家战略需求，在集成电路关键核心领域，有助于推动降低我国对外的技术单边依赖。

**单位信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | |
| **单位简介** |  | | | |
| **项目负责人** |  | | **联系电话** |  |
| **联系人** |  | | **联系电话** |  |
| **通信地址** |  | | **电子邮箱** |  |
| **企业销售额** | **2023年** |  | **2024年**  **（上半年）** |  |
| **企业人员规模** | **2023年** |  | **2024年**  **（上半年）** |  |
| **净利润**  **（大致的量级）** |  | **近三年企业研发投入占营业收入的比重** | |  |
| **融资轮次** |  | **公司近两年有无上市意向（如有，请填写下行内容）** | |  |
| **拟上市地（主板/中小板/创业板/科创板/其他）** |  | **上市进程（已改制/辅导中/已受理/其他）** | |  |
| **公司已获得（含受理中）发明专利（含国防专利）情况** |  | | | |
| **企业规模分类** | □大型 □中型 □小型 | | | |
| **是否为“专精特新”企业** | □是（□国家级 □省级） □否 | | | |
| **融资轮次** |  | | | |
| **外扩需求** | □是 □否 | | | |

**申报产品信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申报产品名称及**  **型号/推出时间** | 名称：  型号：  推出时间： | | | | | | |
| **产品应用场景分类** | □消费级 □工业级 □车规级 □其他： | | | | | | |
| **申报产品**  **按工艺分类** | 注：如CMOS、BCD、HV、Analog、RF、GaAs、MEMS等 | | | | | | |
| **本芯片的知识产权归属** | * 属于申请单位 * 属于母公司 * 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请注明） | | | | | | |
| **芯片概述**  **（包括但不限于产品基本信息、技术创新优势、战略发展意义等）** |  | | | | | | |
| **芯片体系结构图** |  | | | | | | |
| **封装形式** | 封装厂 |  | | | 封装/生产工艺 | |  |
| **生产工艺** | 代工厂 |  | | | 生产工艺 | |  |
| **主要性能和指标** | 注：请提交产品手册等资料 | | | | | | |
| **本产品的创新性及所获得的知识产权形式** | **已受理专利项数** | | |  | | | |
| **已获取专利项数** | | |  | | | |
| 注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料 | | | | | | |
| **本产品的应用市场及销售情况** |  | | **销售总额**  **（单位：万元）** | | | **销售量**  **（单位：万颗）** | |
| **自产品推出之时起至今** | |  | | |  | |
| **2023年全年** | |  | | |  | |
| **2024年上半年** | |  | | |  | |
| **2024年全年预计** | |  | | |  | |
| **市场份额** | | （注：根据市场总量实际估测） | | | | |
| **对标国外相关芯片产品的情况** | （注：请列出本产品与国外同类产品在技术参数、国内外市场占有率方面的具体情况对比，最好能体现国外相关产品的具体型号） | | | | | | |
| **本产品的主要客户及应用案例介绍** |  | | | | | | |
| **法律声明：**  **申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。**  法人/授权代表签名：  企业（盖章）  日期： | | | | | | | |

**注：本表填写内容仅用于专家评选审阅，不对外公开。**